

2026 年 9 月 25 日

株式会社進和

TPCA Show 2026 【TAIPEI】 出展のお知らせ

株式会社進和は、台湾・台北で開催される国際展示会「TPCA Show 2026 TAIPEI」に出展いたします。

本展示会は、PCB 製造、電子産業、先進パッケージングなどの分野における最新技術・ソリューションが集まる展示会です。

進和ブースでは、半導体分野に向けた基板実装、AI サーバー、IC チップ、パッケージ技術などをテーマに、当社の取り組みをパネル展示にてご紹介いたします。



■ 開催概要

- ・展示会名：TPCA Show 2026
- ・会期：2026 年 10 月 20 日（火）～22 日（木）
- ・会場：TaiNEX 1（台北南港展覽館 1 館）
- ・小間番号：L-331

■ 出展内容

出展内容は、半導体・エレクトロニクス分野に関連する技術紹介を中心に、基板実装からパッケージ技術まで、進和の提案領域をわかりやすくご案内する内容を予定しています。

展示会や出展に関する詳細については、TPCA Show 2026 公式サイトよりご確認ください。

公式サイト URL：https://www.tpcashow.com/

ご来場の際は、ぜひ進和ブースまでお立ち寄りください。

以 上

TPCA Show

— TAIPEI —

2026.10.20 (TUE) - 22 (THU)

台北南港展覽館1館 1、4樓 TaiNEX 1

Energy-Efficient 

From Computing to Systems and Applications

4F 1Booths

L-331

超精密塗布装置のリーディングカンパニーであり、半導体関連ソリューションを幅広く取り扱う進和が台湾初出展！

出展予定物

ディスペンサー

80μm以下の微小塗布、最高500shot/secの高速塗布を実現する、業界屈指の精密塗布装置メーカーです。動画や塗布サンプルで実際の塗布速度や出来栄をご覧ください。

 Shinwa Co., Ltd.



縦型仮貼機

樹脂フィルムを基板に縦向きで仮貼りする、新発想の縦型仮貼機。
・製品面の露出を抑制
・異物混入を防止
などの多彩なメリットをご紹介します。





リフロー炉

材料を知り尽くした材料メーカーならではのメリットが詰まったリフロー炉とフローはんだ付け装置の、幅広いラインナップをご紹介します。

- ・窒素使用量削減
- ・ボイド低減
- ・飛散低減





ウェットブラスト

めっき前クリーニングによる密着性向上、樹脂層パターンニング、レジスト残渣除去など、様々な工程で品質向上に貢献するウェットブラスト。ご活用例をパネルにてご紹介します。





ダイシング

SiCや、窒化アルミ、水晶、石英、ガラス、複合材など脆性材料の切断において、以下の強みを発揮します。

- 【高品質】
- チップングの改善
- 【低コスト】
- ブレードの高寿命化
- 【高生産性】
- カットスピードの改善





 Shinwa Co., Ltd.